

金禄电子科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告（五）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开的第二届董事会第七次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币46,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

二、担保进展情况

为满足经营发展需要，湖北金禄向中国建设银行股份有限公司安陆支行（以下简称“建设银行”）申请授信。公司与建设银行签订《最高额保证合同》，为上述授信业务项下湖北金禄应承担的债务提供人民币10,000万元的最高额连带责任保证。

本次担保前，公司已签署担保合同或出具担保函为湖北金禄提供担保的总金额为35,300.00万元，可用担保额度为15,500万元；本次担保后，公司已签署担保合同或出具担保函为湖北金禄提供担保的总金额为45,300.00万元，可用担保额度为5,500万元。

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：湖北金禄科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：安陆市江夏大道特8号

5、法定代表人：李继林

6、注册资本：88,513万元

7、成立日期：2017年12月21日

8、经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装基板项目的筹建；金属模具研发、制造、销售；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

主要财务指标	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	1,521,105,234.73	1,490,078,315.07
负债总额	508,748,732.26	487,692,262.88
所有者权益	1,012,356,502.47	1,002,386,052.19
	2024年1-3月	2023年度
营业收入	187,436,644.40	703,018,586.33
利润总额	9,935,700.41	25,523,250.04
净利润	9,799,608.70	25,807,811.59

10、湖北金禄不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项。

四、担保协议的主要内容

公司与建设银行于2024年5月23日签订了《最高额保证合同》，主要内容如下：

1、债权人：中国建设银行股份有限公司安陆支行

2、债务人（被保证人）：湖北金禄科技有限公司

3、保证人：金禄电子科技股份有限公司

4、保证范围：债权人与债务人在2024年5月23日至2027年5月22日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件项下的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、

拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。本最高额保证项下保证责任的最高限额为(币种)人民币(金额大写)壹亿元整。

5、保证期间：保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

6、保证方式：连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司已审批的担保额度总金额为97,550.00万元，占公司2023年末净资产的58.85%；实际签署担保合同或出具担保函对应的担保总金额(含本次担保)为92,050.00万元，占公司2023年末净资产的55.54%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公司的担保总金额为45,300.00万元；子公司对母公司的担保总金额为46,750.00万元。

公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司与建设银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十四日